

# QuickSinter<sup>®</sup>

高金属含量烧结膏，  
重新定义电力电子烧结技术



## 无压烧结膏

### InBAKE<sup>™</sup>

目标应用：功率分立器件高铅焊料替代，功率器件、  
RF GaN 和大功率 LED 芯片贴装

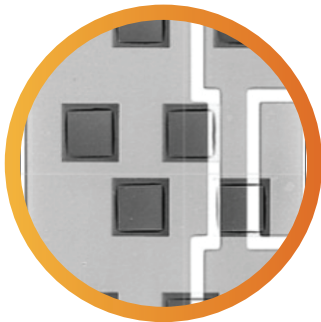


### InBAKE<sup>™</sup> AgCu

#### 无压银烧结膏

特点:

- 可在“类似回流”炉温曲线完成烧结，适用于小芯片应用
- 银、铜界面均可烧结
- 适用于印刷和点胶应用

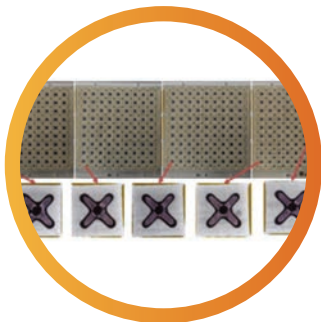


### InBAKE<sup>™</sup> MP

#### 无压银烧结膏

特点:

- 适用于印刷和点胶应用
- 可室温储存
- 银、金、铜界面均可烧结

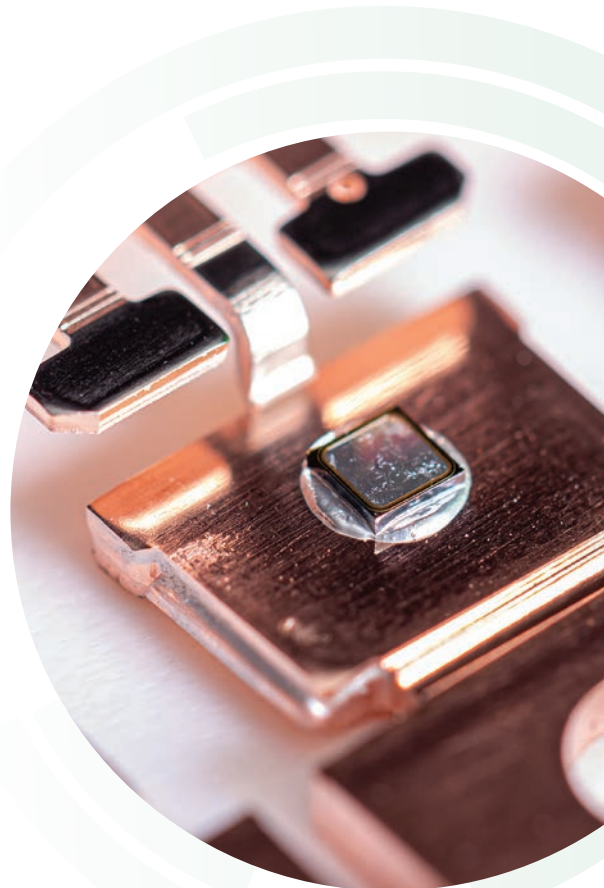


### InBAKE<sup>™</sup> 29

#### 无压铜烧结膏

特点:

- 高一致性的点胶性能
- 适用加压或无压烧结应用
- 无压烧结剪切强度 >25MPa



[indium.com/products/silver-sintering](http://indium.com/products/silver-sintering)

联系我们的工程师: [china@indium.com](mailto:china@indium.com)

有关详情: [www.indiumchina.cn](http://www.indiumchina.cn)

From One Engineer To Another<sup>®</sup>

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证  
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 钢泰公司

表格编号: 100059 (SC A4) R0



# QuickSinter®

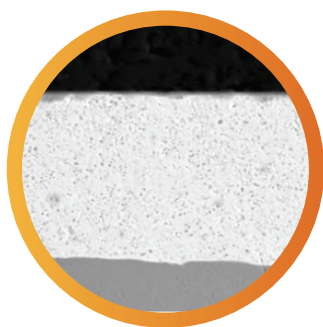
## 高金属含量烧结膏， 重新定义电力电子烧结技术



# 加压烧结膏

## InFORCE™

目标应用：功率模块芯片和模块-散热器贴装

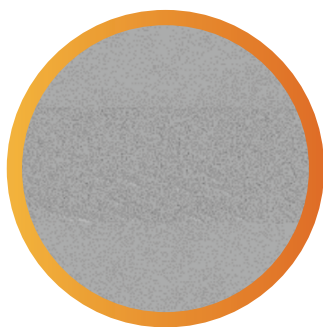
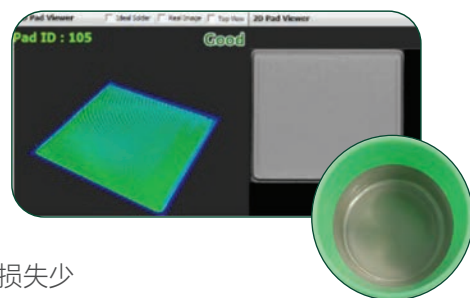


### InFORCE™ MF 有现货

用于芯片贴装的加压银烧结膏

特点：

- 专为印刷应用设计，减少印痕
- 高金属含量和低有机物含量。预烘烤时间短，质量损失少
- 适用于多种金属处理，银、金、铜界面均可烧结
- 尤其适用于 Si IGBT、SiC MOSFET 和 GaN HEMT 芯片贴装
- 5x5 SiC MOSFET 剪切强度 >50MPa



### InFORCE™ 29 有现货

加压铜烧结膏

特点：

- 可印刷或点胶
- 银、金、铜界面均可烧结
- 可在氮气、真空、氮氢混合气体或甲酸气氛或环境中烧结
- 剪切强度 >40MPa
- 高金属、低有机物含量



### InFORCE™ LA 研发中

用于大面积芯片或模块烧结的加压银烧结膏

特点：

- 专为大面积烧结应用而设计
- 可在芯片贴装后再进行烘烤（湿法工艺）
- 适用于“类似印刷”的点胶作业（排式喷嘴点胶）

[indium.com/products/silver-sintering](http://indium.com/products/silver-sintering)

联系我们的工程师: [china@indium.com](mailto:china@indium.com)

有关详情: [www.indiumchina.cn](http://www.indiumchina.cn)

**From One Engineer To Another®**

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证  
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 钢泰公司

表格编号: 100059 (SC A4) R0

